

한화비전

2025년 1분기 실적발표

Disclaimer

본 자료의 실적과 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 (잠정)자료로 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 것으로 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있으며, 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.



1. 2025년 1분기 실적발표

▼ 1Q25 손익계산서 (연결)

(단위 : 억원)

구분	4Q24	1Q25	QoQ
매출액	3,538	4,518	27.7%
매출원가	1,701	2,072	21.8%
매출총이익	1,837	2,446	33.2%
매출총이익률	51.9%	54.1%	2.2%p
판관비	1,205	1,326	10.0%
연구개발비	688	677	-1.6%
영업이익	-55	443	흑자전환
영업이익률	-1.6%	9.8%	11.4%p
영업외손익	353	-574	적자전환
법인세차감전순이익	298	-131	적자전환
법인세비용	-130	-103	-
당기순이익	428	-33	적자전환
당기순이익률	12.1%	-0.7%	-12.8%p

▼ 주요내용

[매출액]

- 1분기 매출액 4,518억 기록하며 전분기 대비 27.7% 증가
- 시큐리티 사업, 분기기준 역대 최대매출액 달성
- 산업용장비 사업, 고객사 수요 회복되며 SMT 매출액 전분기 대비 29% 증가

[영업이익]

- 1분기 영업이익 443억, 영업이익률 9.8% 기록 하며 흑자 전환
- 시큐리티 사업 분기기준 역대 최대 영업이익률 달성
- HBM용 TC본더 이익은 2분기부터 본격 반영 예정

[영업외 손익]

- 현금결제형 주식기준보상 평가손실 576억원 발생

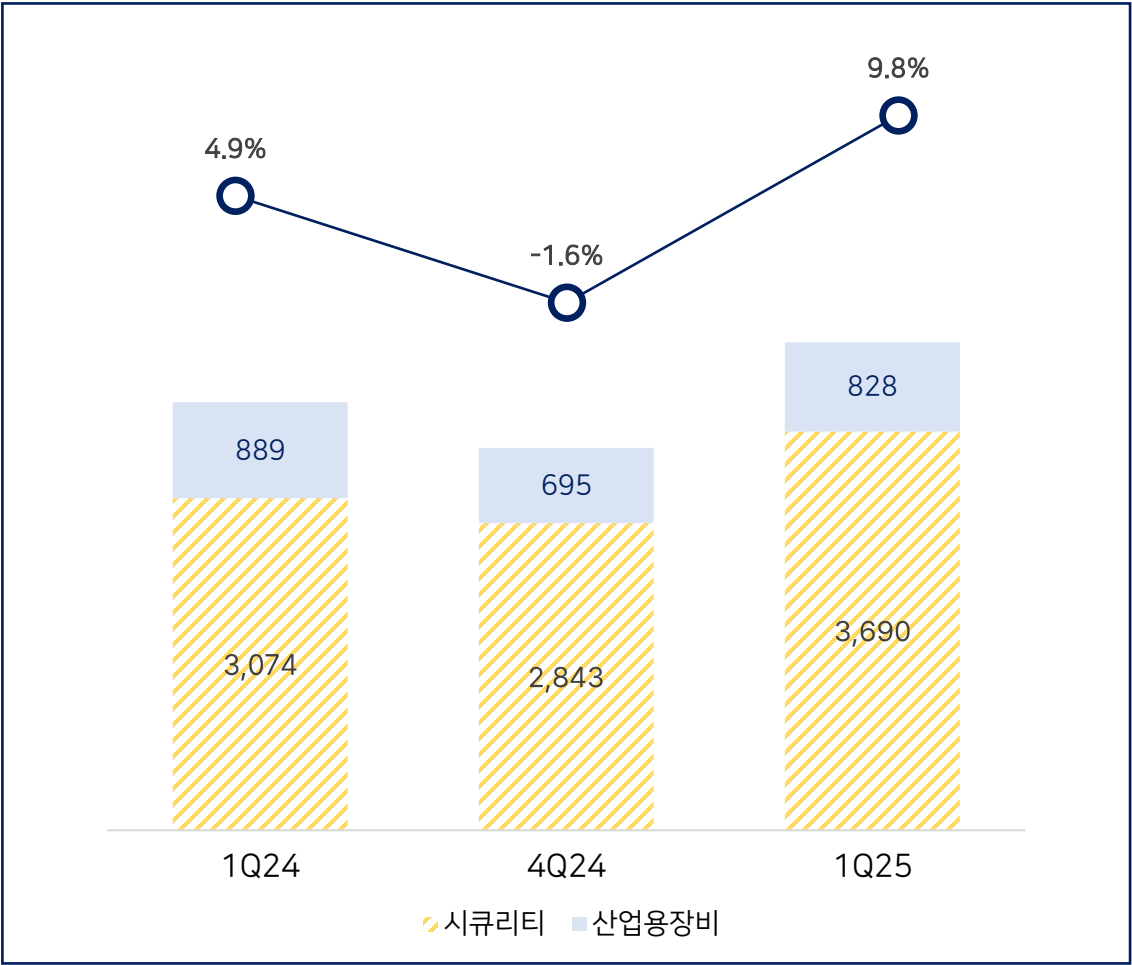
사업부 별 분기 실적

» 한화비전은 '24년 9월 1일 신설되어 그 이전 매출 및 이익은 존재하지 않습니다

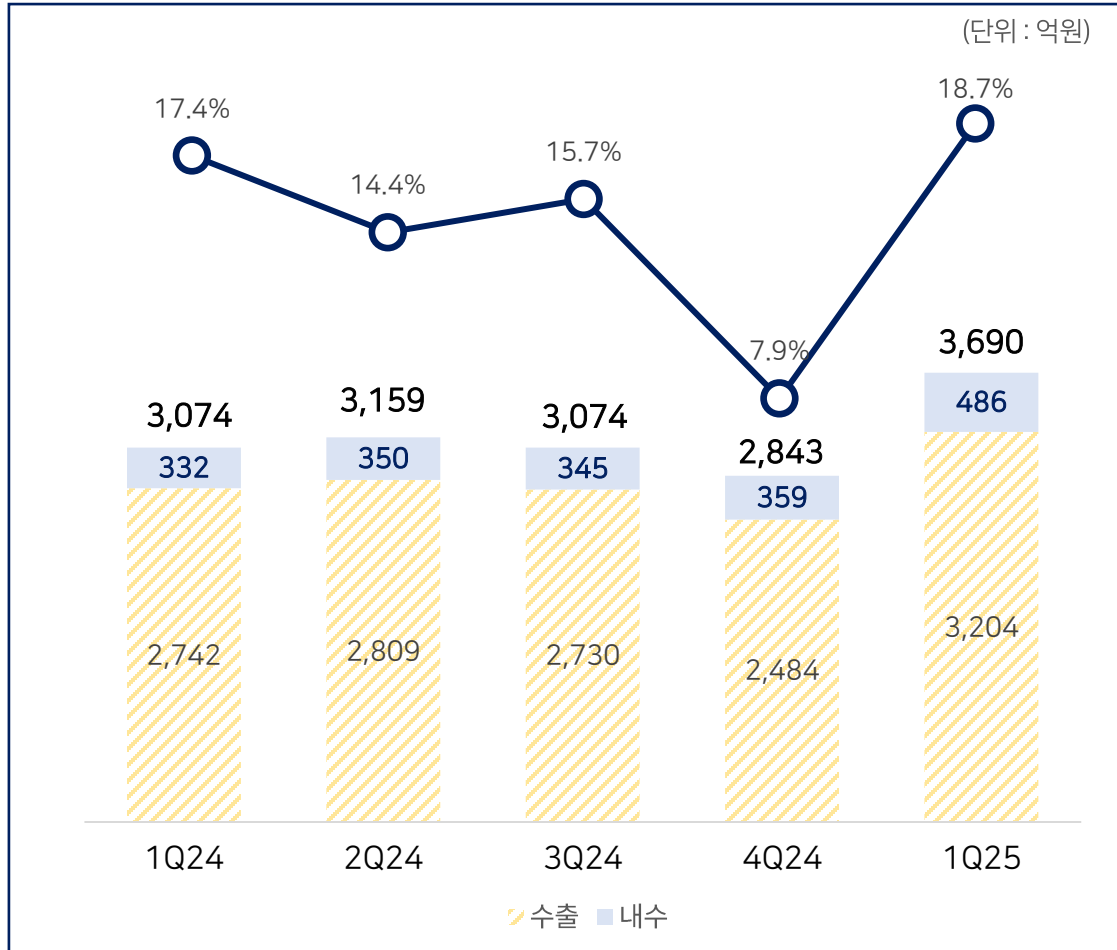
[투자자들의 이해를 돕고자 하기 실적은 분할 전 존속법인이 작성한 사업보고서 또는 IR자료 내 분할 신설예정 사업부분과 그 존속법인의 매출 및 이익의 단순 합산입니다.]

▼ 주요 매출 및 영업이익

구분	1Q24	4Q24	1Q25	증감률	
				YoY	QoQ
매출액	3,989	3,538	4,518	13.3%	27.7%
시큐리티	3,074	2,843	3,690	20.0%	29.8%
수출	2,742	2,484	3,204	16.8%	29.0%
내수	332	359	486	46.4%	35.4%
산업용장비	889	695	828	-6.9%	19.1%
SMT	661	499	644	-2.6%	29.1%
그 외 기타	228	196	184	-19.3%	-6.1%
반도체설계	26	-	-	-	-
영업이익	196	-55	443	126.0%	흑자전환
(%)	4.9%	-1.6%	9.8%	4.9%p	11.4%p
시큐리티	516	224	691	33.9%	208.5%
(%)	16.8%	7.9%	18.7%	1.9%p	10.8%p
산업용장비	-226	-241	-205	-9.3%	-14.9%
(%)	-25.5%	-34.7%	-24.8%	0.7%p	9.9%p
반도체설계	-93	-38	-43	적자축소	적자확대
(%)	-362.8%	-	-	-	-



▼ 분기별 매출 및 영업이익률



▼ 주요 내용

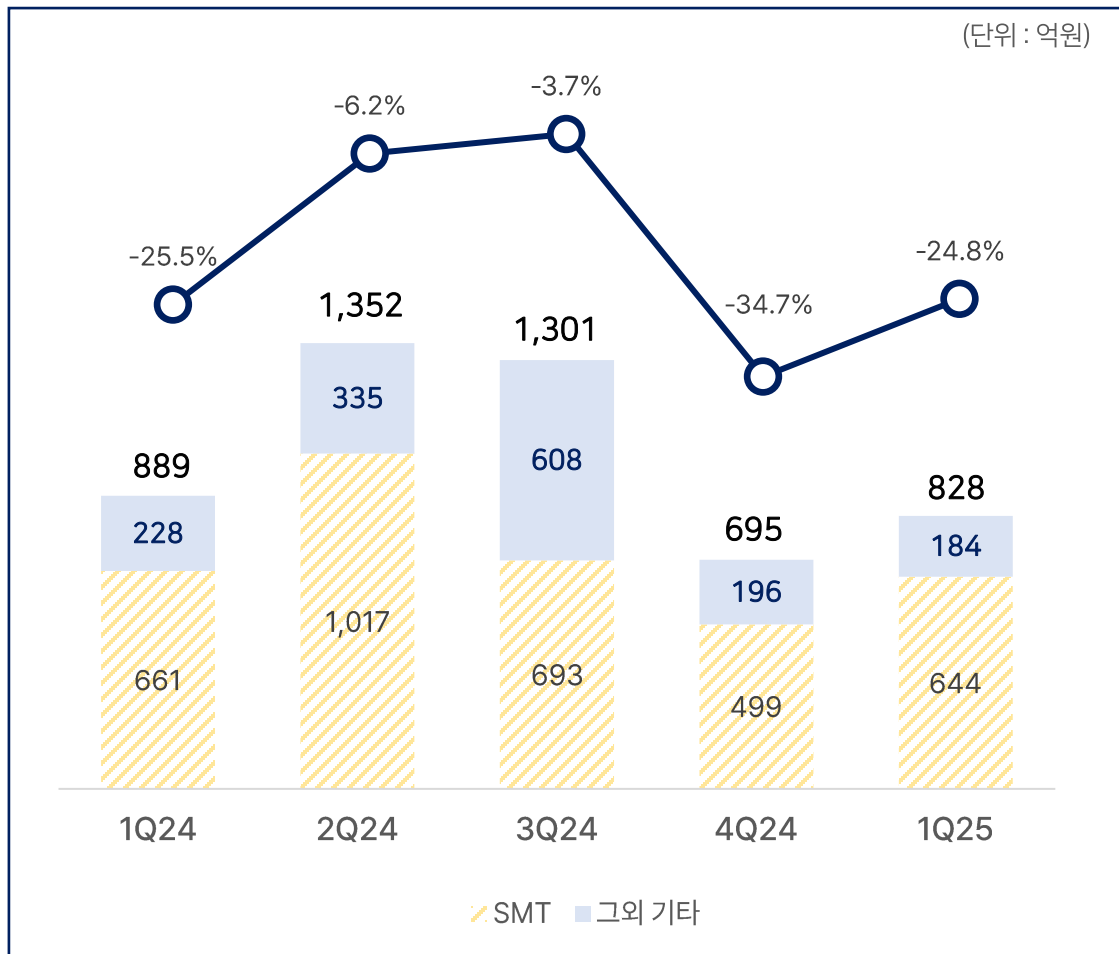
[시큐리티]

- 1Q25 매출액 3,690억원, 영업이익률 18.7% 기록함
- 분기별 사상 최대 매출 및 영업이익 달성
- 미주지역 포함한 글로벌 전역에서 감시장비 수요 증가 및 우호적인 환율효과 유지되며 매출 증가 (YoY, QoQ)

[반도체 설계]

- 25년 4월 Wisenet 9 신규 칩셋 출시
 - Dual NPU를 탑재하여 AI 영상분석 기능 및 화질 기능 대폭 향상
 - AI 카메라 점유율 향상에 기여할 것으로 전망

▼ 분기별 매출 및 영업이익률



▼ 주요 내용

[공통]

- 1Q25 매출액 828억원, 영업이익률 -24.8%

[SMT]

- 1Q25 매출액 644억 달성
- 고객사 수요 일부 회복되며 매출 증가(QoQ)

[그외 기타]

- 그 외 기타 부문매출액 184억 달성
- HBM용 TC본더 매출 및 이익은 2Q부터 본격 인식 예정

연결재무제표 (1Q25)



(단위 : 억원)

구분	1Q25
자산	
유동자산	10,009
현금및현금성자산	891
기타금융자산	244
매출채권및기타채권	5,377
재고자산	3,219
기타유동자산	183
비유동자산	6,124
장기매출채권및기타채권	85
사용권자산	370
유형자산	3,203
무형자산	855
기타비유동금융자산	36
기타비유동자산	78
이연법인세자산	1,497
자산총계	16,134

(단위 : 억원)

구분	1Q25
부채	
유동부채	5,070
매입채무및기타채무	1,685
유동성차입금	2,583
미지급법인세	349
리스부채	121
파생상품부채	14
기타유동부채	318
비유동부채	2,783
장기매입채무및기타채무	1,291
장기리스부채	220
종업원급여부채	1,190
이연법인세부채	82
부채총계	7,853
자본	
지배기업주주지분	8,271
자본금	252
자본잉여금	7,032
자본조정	-39
기타포괄손익누계액	927
이익잉여금	99
비지배지분	9
자본총계	8,281



2. APPENDIX

Global Top-tier : Global Top 5, America Top 3

Global Market Share (*중국시장제외)

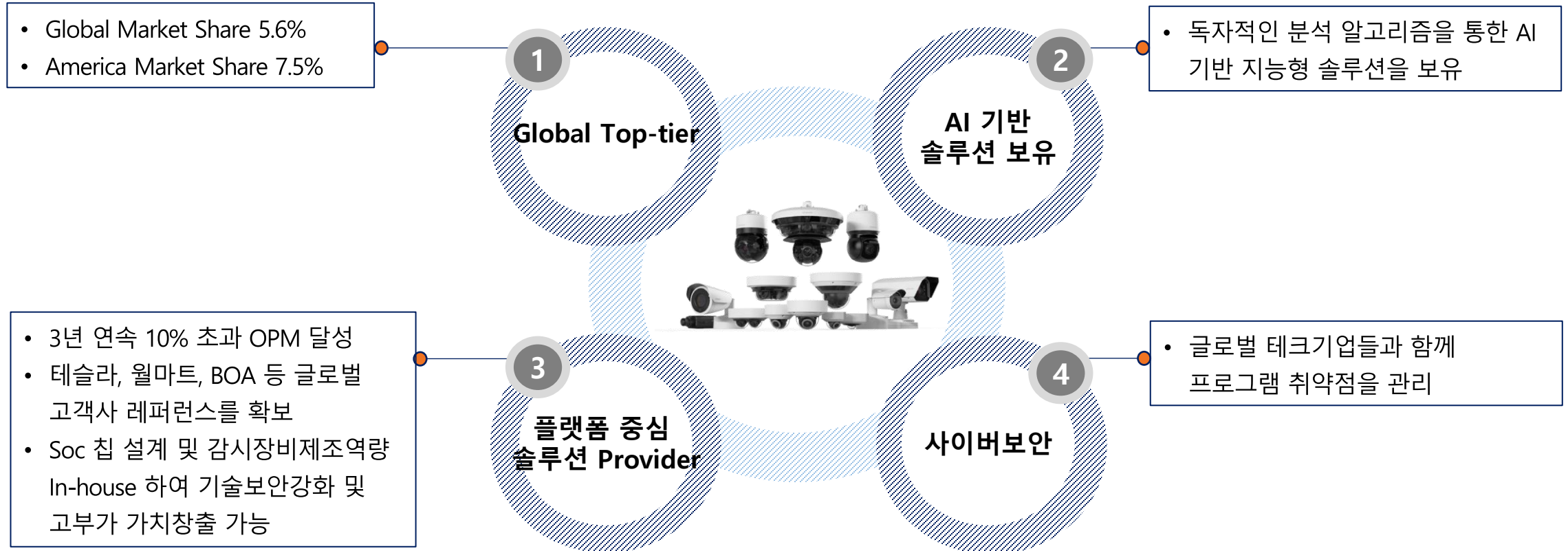
	'21년	'22년	'23년
 HIKVISION	15.8%	14.7%	14.2%
 AXIS COMMUNICATIONS	10.7%	10.9%	10.7%
 MOTOROLA	7.3%	7.5%	7.7%
 alhua TECHNOLOGY	9.0%	7.8%	7.0%
  한화비전	5.1%	5.7%	5.6%
 BOSCH	4.0%	3.8%	3.8%
 PRO Panasonic	4.3%	3.8%	3.7%

*Source: OMDIA

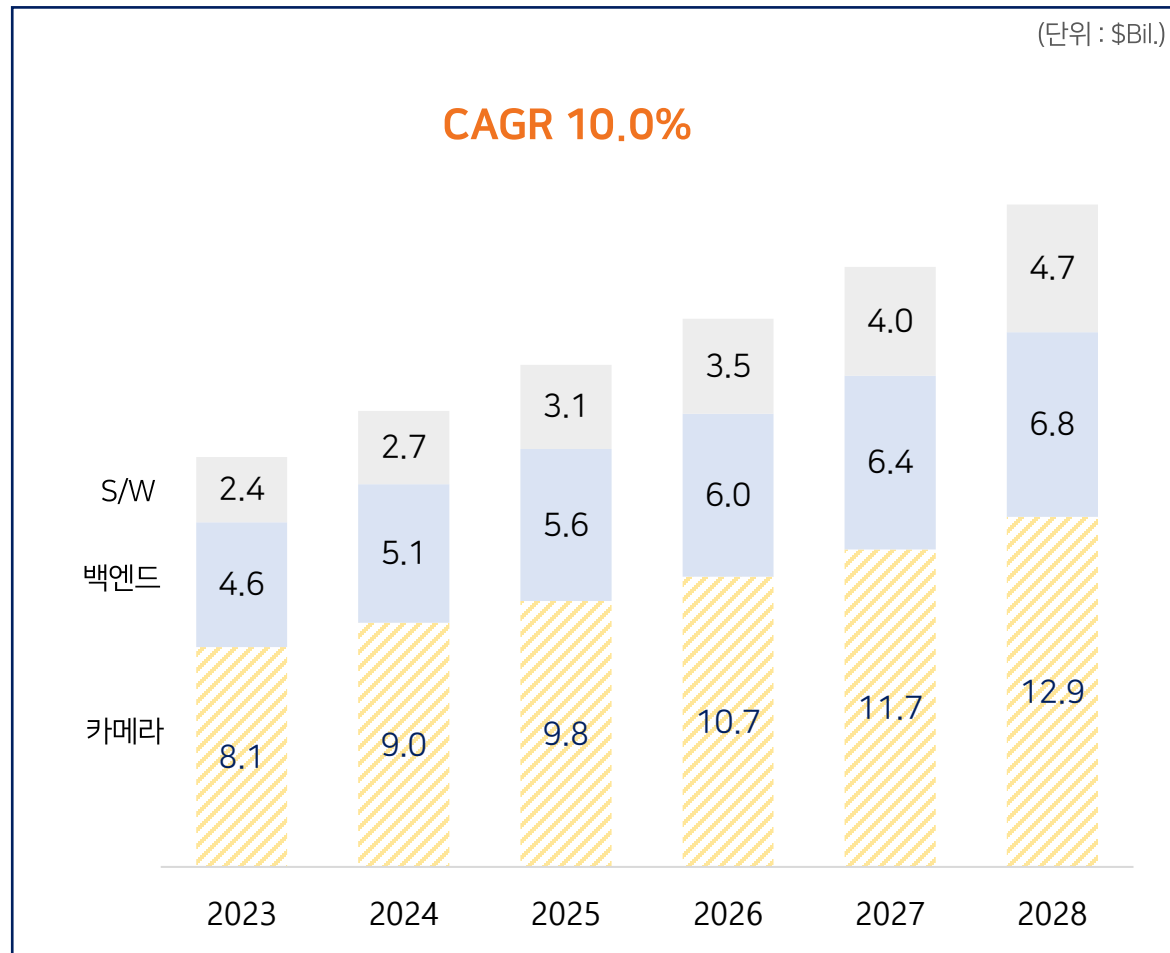
America Market Share

	'21년	'22년	'23년
	13.9%	14.5%	14.1%
	11.5%	12.3%	12.2%
	5.9%	7.6%	7.5%
HIKVISION	6.6%	5.6%	5.2%
Genetec	4.9%	4.4%	4.4%
 Verkada	N/A	N/A	4.3%
	4.6%	4.3%	4.2%

*Source: OMDIA

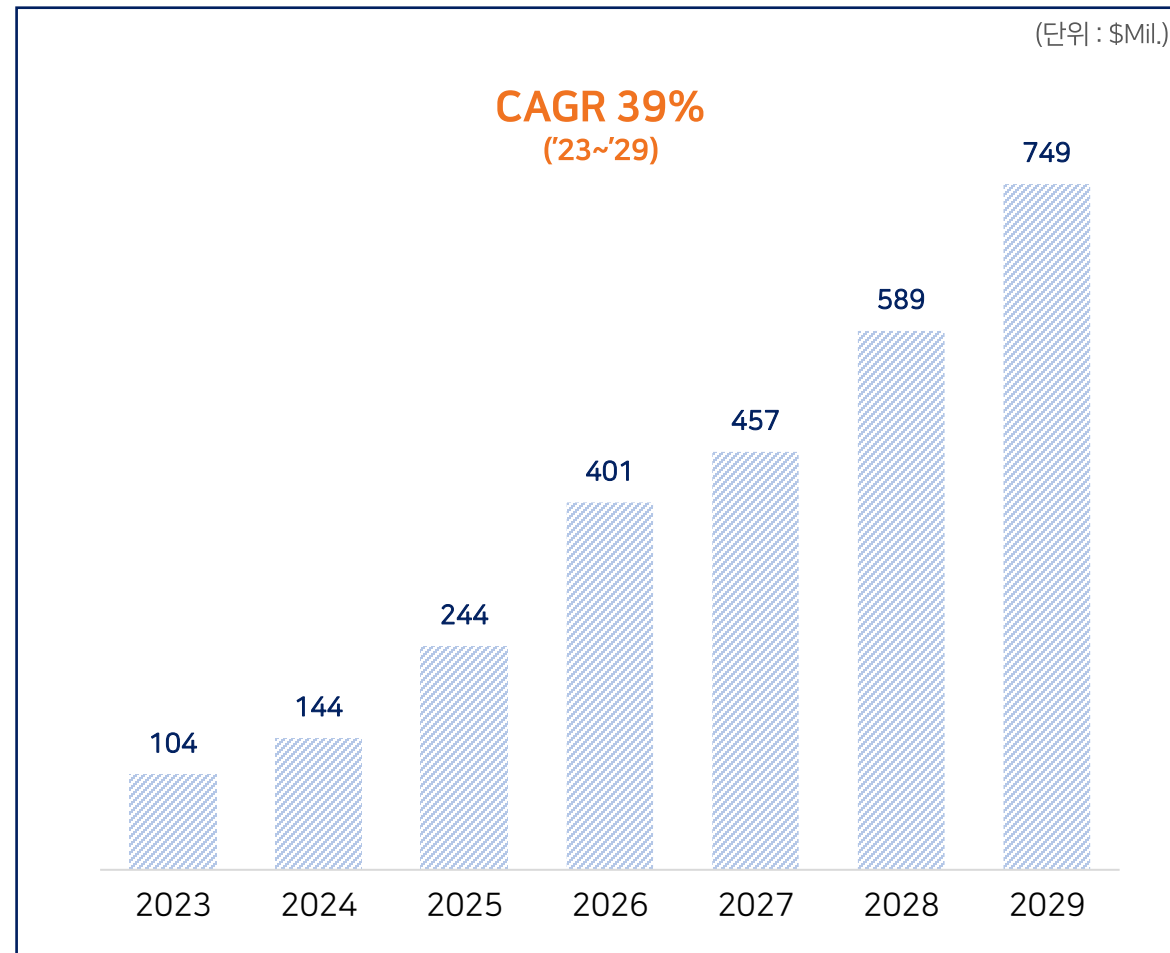


글로벌 보안시장 전망 (*중국시장제외)



(출처 : OMDIA)

Advanced Die Attach 시장

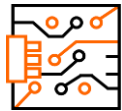


(출처 : Techinsights, Dec. 2024)

SMT

(Surface Mounting Technology)

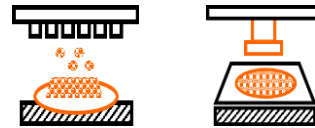
사업 연혁 36년



인쇄회로기판 (PCB)에 다양한 전자부품을
실장하기 위한, 초정밀 Pick & Place와 Vision
Alignment 기술 및 최적화 S/W 솔루션,
주변기기 통합 인라인 솔루션을 보유

반도체 증착, 패키징

사업 연혁 16년 (기술 개발 32년)



고성능 반도체 제조를 위해 필요한
초미세 패터닝 증착 기술과 HBM에
필수인 Advanced Packaging을 위한
다양한 후공정 본딩 기술을 보유

CNC 자동선반, 덴탈밀링

사업 연혁 48년



자동차 부품부터 의료용 부품까지
다양한 소재를 가공하는 초정밀
제어/가공 기술을 보유, 덴탈밀링까지
전방위 제조장비 라인업 구축



SMT 글로벌 대형 고객 확보

수익 확대 및 성장성 확보를 위한 하이엔드 고속기,
인라인 제조 솔루션 기반 사업 강화



반도체 대형사 레퍼런스 기반 사업 확대

국내 대형 고객과의 공동개발 및 평가를 바탕으로
신기술과 시장을 선점하여, 글로벌 시장 공략



초정밀 가공 사업확대

공작기계의 기존 사업구조를 탈피하여,
고수익 전망되는 의료기기 분야로 사업 확장



Advanced Manufacturing Solution Creator

